



Morgan
McKinley

【外資系半導体ファウンドリ】プロセスエンジニア | 三重

大規模な300mmウェハ製造環境で、充実した待遇と働きやすさを両立

Job Information

Recruiter

Morgan McKinley

Job ID

1617077

Industry

Bank, Trust Bank

Job Type

Permanent Full-time

Location

Mie Prefecture

Salary

Negotiable, based on experience

Refreshed

October 14th, 2026 21:28

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 3 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Fluent

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

大規模な300mmウェハ製造環境で、次世代パワーデバイスや先端ファウンドリ技術の量産化を支えるプロセスエンジニアを募集しています。

半導体プロセスの開発・改善から量産立ち上げまで、幅広い工程に携わりながら、歩留まり向上や生産性向上など、製造技術の高度化を推進します。

300mmファウンドリの大規模な量産環境で専門性を高めながら、競争力のある報酬と年2回の業績賞与、年間休日126日・年間23日の有給休暇など、充実した待遇と働きやすさを両立できるポジションです。

主な職務内容

- リソグラフィ、エッチング、拡散、CMP、CVD、PVD、イオン注入など、主要な半導体モジュール工程における量産プロセスを開発・支援

- ・ 先端ファウンドリ向けの半導体製造プロセス統合を推進
- ・ 付加価値の高いファウンドリ製品の拡大に向け、プロセス設計および製造装置の管理を担当
- ・ 特殊なファウンドリ製品および次世代パワーデバイスの量産立ち上げをリード
- ・ 歩留まり向上、プロセス安定化、生産性向上、コスト削減に向けた製造技術を開発・改善
- ・ ファウンドリ事業全体における半導体プロセスおよび製造装置について、技術面から幅広くサポート

Join an established **semiconductor foundry** as a Semiconductor Process Engineer, developing and optimising advanced module processes and high-volume manufacturing technologies for **300mm wafer fabrication**.

In this role, you will work across core semiconductor manufacturing processes including lithography, etching, diffusion, CMP, CVD, PVD and ion implantation. You will contribute to module technology integration, yield improvement, equipment management and mass-production ramp-up for advanced foundry applications.

You will also play an important role in developing manufacturing technologies for **next-generation power devices and high-value-added foundry options**, helping improve process stability, productivity and cost efficiency.

This is an excellent opportunity for an experienced semiconductor engineer to deepen their expertise in **process development, process integration and high-volume manufacturing** within a large-scale 300mm wafer fabrication environment.

Key Responsibilities

- ・ Develop and support **high-volume semiconductor manufacturing processes** across lithography, etching, diffusion, CMP, CVD, PVD and ion implantation.
- ・ Execute semiconductor process integration activities for advanced foundry applications.
- ・ Develop and optimise module-level process technologies for **300mm wafer fabrication**.
- ・ Design manufacturing processes and manage related equipment to expand high-value-added foundry options.
- ・ Lead and support **mass-production ramp-up** for specialised foundry technologies and next-generation power devices.
- ・ Develop and refine manufacturing technologies to improve yield and process stability.
- ・ Drive productivity improvements and cost-reduction initiatives across semiconductor manufacturing operations.
- ・ Provide technical support for semiconductor processes and manufacturing equipment across the foundry business.
- ・ Collaborate with relevant engineering and manufacturing teams to resolve technical issues and support stable mass production.

Required Skills

必須条件経験・資格：

- ・ 以下いずれかの工程におけるプロセス開発、プロセス統合、または量産立ち上げの実務経験：縦型炉 / ウェハ洗浄 / イオン注入 / 1枚ウェハRTP
- ・ 半導体プロセス開発、またはモジュールレベルのプロセス技術に関する実務経験
- ・ パワーデバイス開発、製造技術、生産技術、または後工程プロセス開発の実務経験
- ・ 半導体技術および製造原理に関する基礎的な理解
- ・ 高等専門学校（高専）卒以上、かつ関連する技術分野を専攻していること

ソフトスキル：

- ・ 担当業務に主体的に取り組み、オーナーシップを持ってプロジェクトを前に進める力
- ・ 新しい半導体技術を積極的に学び、継続的に知識・スキルを高める姿勢
- ・ 関係者と円滑に連携し、技術的な課題や情報を共有しながら業務を進める力

語学力：

- ・ 日本語：流暢
- ・ 英語：初級（TOEIC 500点以上、または業務で英語を使用した実務経験があれば尚可）

歓迎条件

- ・ 半導体製造業界での実務経験

採用企業について

大規模な300mmウェハ製造工場を運営する、半導体受託製造の専門企業です。

国際的なファウンドリグループの支援を受け、ロジック、モジュール、パワーデバイスなどの半導体技術をグローバル市場に提供しています。

先端ファウンドリ技術の開発から量産まで幅広く手掛け、次世代パワーデバイスを含む高付加価値製品の製造を支えています。

大規模な量産環境の中で、半導体プロセス、モジュールインテグレーション、歩留まり改善、製造技術、装置管理など、幅広い技術領域に携われる環境です。

この求人がおすすめの理由

- ・ 次世代パワーデバイスと300mmファウンドリ技術の開発・量産化に携われる
- ・ 半導体プロセス開発から量産立ち上げまで、幅広い経験を積める
- ・ 昇給制度が整っており、競争力のある報酬を実現
- ・ 年2回の業績賞与
- ・ 残業代は1分単位で支給
- ・ フレックスタイム制度・年間休日126日による充実したワークライフバランス

- 長期休暇制度に加え、年間23日の有給休暇

Required Skills and Qualifications **Experience:**

- Practical experience in **semiconductor process development, process integration or process ramp-up**.
- Hands-on experience involving one or more of the following: vertical furnaces, wafer cleaning, ion implantation or single-wafer RTP.
- Demonstrated experience in semiconductor process development or module-level process technology.
- Hands-on background in **power device development, manufacturing engineering, production technology or back-end process development**.
- Technical college (KOSEN) graduation or higher in a relevant discipline.
- Solid foundational understanding of semiconductor technologies and manufacturing principles.

Soft Skills:

- Strong sense of ownership with the ability to take responsibility for assigned projects and drive them forward.
- Proactive mindset and willingness to continuously learn new semiconductor technologies.
- Strong problem-solving approach when addressing manufacturing and process challenges.
- Ability to work effectively with engineering and manufacturing teams.
- Commitment to improving process stability, yield, productivity and manufacturing performance.

Language Requirements:

- **Japanese:** Fluent level.
- **English:** TOEIC 500+ or practical experience using English in a business environment.

Preferred Skills & Qualifications

- Previous professional experience within the **semiconductor manufacturing industry**.
- Experience working in a semiconductor foundry or high-volume wafer fabrication environment.
- Experience with **300mm wafer manufacturing**.
- Knowledge or experience across lithography, etching, diffusion, CMP, CVD, PVD or ion implantation.
- Experience with advanced semiconductor module integration.
- Experience developing or manufacturing **power semiconductor devices**.
- Experience supporting mass-production ramp-ups, yield enhancement or process optimisation.

About the Company

Our client is an established **contract semiconductor manufacturer** operating large-scale 300mm wafer fabrication facilities.

Supported by an international foundry group, the company provides advanced semiconductor technologies across **logic, module and power devices** for global markets.

Its large-scale manufacturing environment provides semiconductor engineers with opportunities to contribute to advanced process development, technology integration and high-volume production while helping bring next-generation semiconductor technologies into mass production.

Why You'll Love Working Here

- Drive key technical innovations for **next-generation power devices and advanced 300mm foundry solutions**.
- Play an important role in semiconductor process development and mass-production ramp-up.
- Build expertise across module integration, yield enhancement, manufacturing technology and equipment management.
- Work within a large-scale **300mm semiconductor wafer fabrication** environment.
- Receive competitive compensation with structured salary progression.
- Benefit from **performance bonuses twice a year**.
- Receive overtime compensation calculated on a minute-by-minute basis.
- Maintain excellent work-life balance with **flex-time options and 126 annual holidays**.
- Enjoy long seasonal holidays and **23 days of annual paid leave**.

Company Description

Morgan McKinleyは国際的な人材コンサルティング会社として、さまざまな業界・分野をリードする採用企業様と、スペシャリストとしてのスキルを有する人材とを結びつけるお手伝いをしています。1988年の創立以来、Morgan McKinleyの名は、「卓越した質のサービス」「市場知識の豊富さ」「No.1企業であり続けようとする強い意志」、そして何よりも「実績」を体現する会社として知られています。

リクルーティング スペシャリストである弊社コンサルタントまでお気軽にお問い合わせください。